

Effisus 2Bond DS

Preparação de substrato

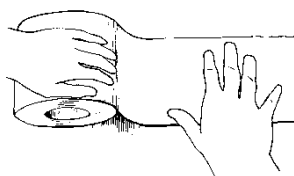
1



Todas as superfícies devem estar secas. Limpe todas as superfícies lisas e não absorventes com o Effisus Cleaner LV. Remova qualquer material solto de substratos absorventes e porosos, como o betão. As operações de colagem não podem ser realizadas a temperaturas inferiores a -29 °C. Para temperaturas entre 4,5 °C e -29 °C, aplique sempre uma camada de Effisus RED+ Primer ou Effisus Coat NP Primer nos substratos.

Colagem

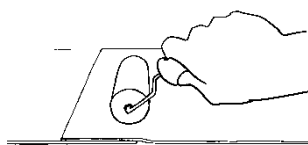
2



Para aplicar a fita Effisus 2Bond DS, remova um lado do revestimento protetor e aplique na superfície a ser protegida ou colada. Esfregue ou passe com pressão usando a mão ou um rolo de aço para ativar o processo de colagem. Remova o segundo revestimento protetor e aplique a segunda superfície na fita, aplicando pressão.

Sobreposições

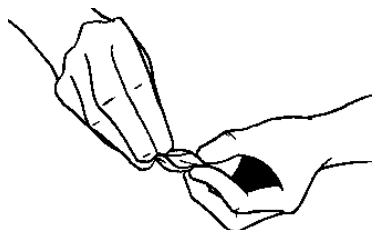
3



As juntas entre as fitas Effisus 2Bond DS devem ter uma sobreposição mínima de 100 mm. Cole a fita Effisus 2Bond DS superior sobre a fita Effisus 2Bond DS inferior. Esfregue ou passe um rolo de aço com pressão para ativar o processo de colagem.

Cordão

4



A fita Effisus 2Bond DS também pode ser usada como massa de selagem. Remova os revestimentos protetores e enrole-a como um cordão. Coloque a Effisus 2Bond DS sobre a abertura e molde-a para selar a abertura. Ela pode ser usada para selar parafusos ou hastes de pregos.